

# 植球助焊剂

- 适用于BGA、WLCSP和FOW/PLP
- 助焊剂流变性适用于各种球的尺寸
- 适用于无铅应用
- 长时间针转移性能一致
- 低空洞
- 良率高（不错失球）
- 在各种表面上可焊性优异
- 只需用去离子纯净水即可洗净

## 主要使用对象

- 移动应用处理器
- 记忆体
- WLCSP、FOWLP



ISO 9001  
REGISTERED

表格编号: 99651 R0  
©2019 钢泰公司

[china@indium.com](mailto:china@indium.com)

INDIUM  
CORPORATION®

# 植球助焊剂

<b>WS-446-AL</b>		可焊性差的情况下的最佳助焊剂，含卤
<b>WS-575-C</b>	针转移	消除OSP的预涂覆助焊剂步骤
<b>WS-823</b>		全能最佳的无卤植球助焊剂，清洗容易
<b>WS-676</b>	印刷	适用于WLCSP
<b>WS-759</b>		润湿良好可控，适用于FOW/PLP

- 黏度稳定，粘性可以保证助焊剂沉积尺寸一致
- 消除预涂覆助焊剂的步骤：
  - 降低工艺成本
  - 最大程度地减小封装的弯曲
  - 提高产率 (UPH)
- 高黏度和快速焊接可以消除回流时的错失球的现象
- 仅用室温去离子纯净水即可洗净，消除了使用化学清洗剂和热水的成本



ISO 9001  
REGISTERED

表格编号: 99651 R0  
©2019 镭泰公司

[china@indium.com](mailto:china@indium.com)

